



2027年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2026年8月6日

上場会社名 TOWA株式会社

上場取引所 東

コード番号 6315 URL <https://www.towajapan.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長執行役員 (氏名) 三浦 宗男

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員経営企画本部長 (氏名) 中西 和彦

TEL 075 - 692 - 0251

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2027年3月期第1四半期の連結業績(2026年4月1日～2026年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年3月期第1四半期	16,183	100.3	2,212	—	2,332	—	1,657	—
2026年3月期第1四半期	8,080	39.0	581	—	732	—	528	—

(注) 包括利益 2027年3月期第1四半期 6,412百万円 (—%) 2026年3月期第1四半期 351百万円 (84.3%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2027年3月期第1四半期	22.09	—
2026年3月期第1四半期	7.05	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2027年3月期第1四半期	116,411	75,526	64.9
2026年3月期	106,267	70,611	66.4

(参考) 自己資本 2027年3月期第1四半期 75,526百万円 2026年3月期 70,611百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年3月期	—	0.00	—	20.00	20.00
2027年3月期	—	—	—	—	—
2027年3月期(予想)	—	0.00	—	24.00	24.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2027年3月期の連結業績予想(2026年4月1日～2027年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	32,000	36.5	5,120	105.3	5,120	113.9	3,500	89.2	46.65
通期	64,000	17.7	10,240	48.0	10,240	47.4	7,000	52.4	93.30

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数 (普通株式)

期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2027年3月期1Q	75,157,367 株	2026年3月期	75,157,367 株
期末自己株式数	2027年3月期1Q	125,703 株	2026年3月期	129,348 株
期中平均株式数 (四半期累計)	2027年3月期1Q	75,029,892 株	2026年3月期1Q	75,008,396 株

(注) 期末自己株式数には、「株式給付信託 (J-ESOP)」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) が保有する当社株式が含まれております。また、「株式給付信託 (J-ESOP)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想等に関する詳細は、添付資料P. 3「1. 経営成績等の概況 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
- 決算説明資料及び決算補足説明資料は、当社ウェブサイトに掲載しております。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
(セグメント情報等の注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、AI関連分野を中心とした投資需要の拡大に支えられ、総じて底堅く推移いたしました。一方で、中東情勢の緊迫化に伴う資源・エネルギー価格の上昇を背景にインフレ圧力が高まり、金融市場の変動や地政学的リスクへの懸念も強まるなど、先行き不透明な状況が続きました。

半導体業界においては、AI・データセンター向け需要を背景に、先端ロジック及びHBMが市場を牽引するとともに、汎用メモリ（DRAM、NAND）においても需給ひっ迫による価格上昇が継続しました。これを受け、半導体各社の設備投資はAI・メモリ関連を中心に拡大しました。

このような事業環境のもと、当社グループの業績は、AI・データセンター向け需要の拡大を背景としたメモリ及び先端パッケージ分野の旺盛な設備投資需要を着実に取り込みました。特にメモリ分野において高い採用実績を有するモールドイング装置の受注が好調に推移した結果、受注高は218億11百万円となり、四半期ベースで過去最高を記録しました。売上高は高水準の受注残高を背景にメモリ向け案件を中心に伸長し、161億83百万円となりました。

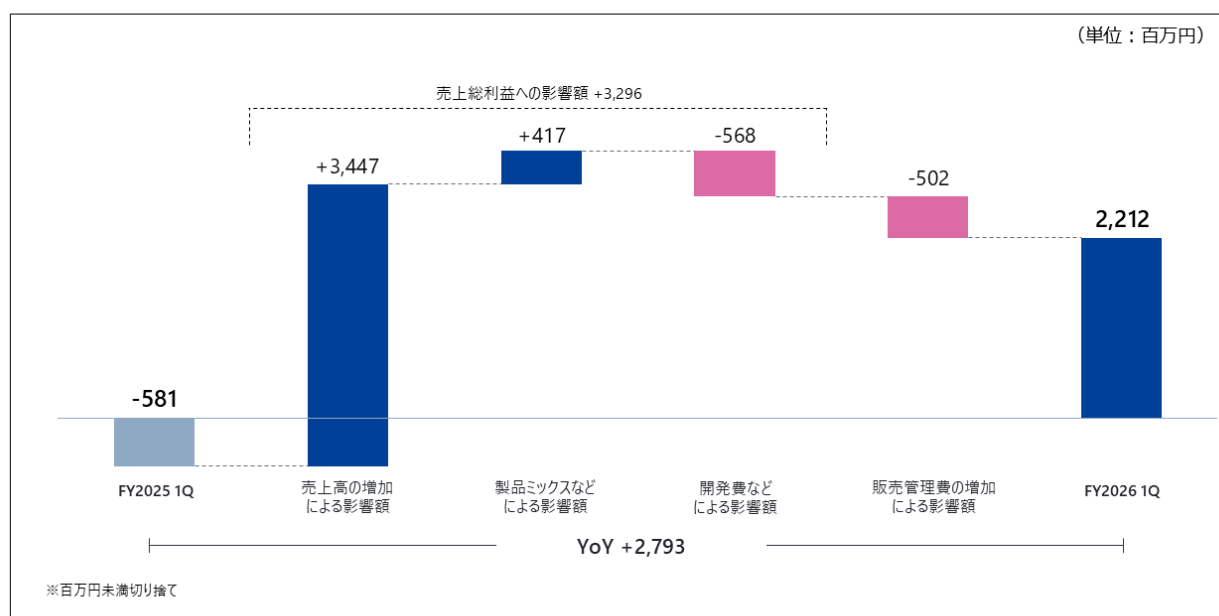
利益面につきましても、増収効果により、各段階利益は前年同期の損失計上から黒字転換し、親会社株主に帰属する四半期純利益は16億57百万円となりました。

当第1四半期連結累計期間の経営成績は次のとおりであります。

売上高	161億83百万円（前年同期比81億3百万円増、2.0倍）
営業損益	22億12百万円（前年同期は営業損失5億81百万円）
経常損益	23億32百万円（前年同期は経常損失7億32百万円）
親会社株主に帰属する四半期純損益	16億57百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失5億28百万円）

当第1四半期連結累計期間の営業損益の主な増減要因（対前年同期）は次のとおりであります。

売上高の増加による影響額	34億47百万円増
製品ミックスなどによる影響額	4億17百万円増
開発費などの増加による影響額	5億68百万円減
販売管理費の増加による影響額	5億2百万円減



セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

〔半導体製造装置事業〕

半導体製造装置事業における経営成績は、データセンター向けを中心にモールドイング装置の販売が伸長したことから、売上高は151億33百万円（前年同期比79億30百万円増、2.1倍）となりました。利益につきましては、増収効果及び製品ミックスの改善により、営業利益21億26百万円（前年同期は営業損失6億7百万円）となりました。

〔メディカルデバイス事業〕

メディカルデバイス事業における経営成績は、医療用成形品及び組立品の需要が堅調に推移するとともに、顧客基盤の拡大が進んだことから、売上高6億80百万円（前年同期比86百万円、14.5%増）、営業利益1億32百万円（前年同期比29百万円、29.3%増）となりました。

〔レーザ加工装置事業〕

レーザ加工装置事業における経営成績は、レーザ溶接機の販売増加により売上高は3億69百万円（前年同期比86百万円、30.3%増）となったものの、主力製品であるレーザトリマの需要低迷が継続していることから、営業損失46百万円（前年同期は営業損失75百万円）となりました。

（2）当四半期の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末における総資産合計は、前連結会計年度末に比べ101億43百万円増加し1,164億11百万円となりました。これは主に、保有有価証券の時価上昇等により投資有価証券が57億46百万円増加したほか、現金及び預金が12億93百万円、受取手形及び売掛金が16億10百万円増加したことによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ52億29百万円増加し408億84百万円となりました。これは主に、運転資金等に係る短期借入金が35億円増加したほか、固定負債のその他が増加したことによるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ49億14百万円増加し755億26百万円となりました。これは主に、保有有価証券の評価額上昇に伴いその他有価証券評価差額金が39億40百万円増加したことに加え、為替換算調整勘定が8億24百万円、利益剰余金が1億55百万円増加したことによるものであります。

その結果、当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率は64.9%となり、前連結会計年度末の66.4%から1.5ポイント低下いたしました。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2026年5月11日の「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	28,431,711	29,724,824
受取手形及び売掛金	16,163,686	17,774,389
電子記録債権	201,287	108,787
リース債権及びリース投資資産	12,955	11,313
商品及び製品	5,681,054	6,136,370
仕掛品	11,830,117	12,541,174
原材料及び貯蔵品	2,279,450	2,336,084
その他	2,596,216	2,635,765
貸倒引当金	△28,502	△6,984
流動資産合計	67,167,977	71,261,726
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	24,872,224	25,098,547
減価償却累計額	△14,808,340	△15,092,991
建物及び構築物（純額）	10,063,884	10,005,555
機械装置及び運搬具	20,502,224	20,815,433
減価償却累計額	△14,149,039	△14,586,493
機械装置及び運搬具（純額）	6,353,184	6,228,939
土地	6,635,889	6,636,616
リース資産	1,958,276	2,011,941
減価償却累計額	△716,646	△749,726
リース資産（純額）	1,241,629	1,262,215
建設仮勘定	766,950	840,541
その他	5,893,780	6,085,133
減価償却累計額	△4,760,340	△4,916,126
その他（純額）	1,133,439	1,169,006
有形固定資産合計	26,194,978	26,142,875
無形固定資産	2,241,001	2,417,948
投資その他の資産		
投資有価証券	7,554,505	13,301,120
退職給付に係る資産	937,507	952,645
その他	2,171,802	2,334,711
投資その他の資産合計	10,663,815	16,588,477
固定資産合計	39,099,795	45,149,301
資産合計	106,267,772	116,411,028

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,432,148	5,240,690
電子記録債務	25,653	14,291
短期借入金	11,500,000	15,000,000
1年内返済予定の長期借入金	2,120,000	1,995,000
未払法人税等	1,079,860	921,081
製品保証引当金	299,462	326,905
賞与引当金	1,330,104	935,779
役員賞与引当金	143,716	28,187
その他	5,628,008	6,912,569
流動負債合計	27,558,954	31,374,506
固定負債		
長期借入金	4,000,000	3,595,000
退職給付に係る負債	1,081,681	1,089,601
株式給付引当金	133,620	147,079
その他	2,881,680	4,678,751
固定負債合計	8,096,982	9,510,433
負債合計	35,655,936	40,884,939
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,985,585	8,985,585
資本剰余金	480,895	480,895
利益剰余金	48,570,745	48,725,990
自己株式	△110,772	△107,001
株主資本合計	57,926,454	58,085,470
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,948,622	8,889,076
為替換算調整勘定	7,620,024	8,444,307
退職給付に係る調整累計額	116,733	107,234
その他の包括利益累計額合計	12,685,381	17,440,618
純資産合計	70,611,835	75,526,088
負債純資産合計	106,267,772	116,411,028

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
売上高	8,080,222	16,183,487
売上原価	5,926,361	10,733,386
売上総利益	2,153,860	5,450,100
販売費及び一般管理費	2,735,247	3,238,098
営業利益又は営業損失(△)	△581,386	2,212,002
営業外収益		
受取利息	26,635	51,030
受取配当金	62,195	70,277
雑収入	94,755	172,274
営業外収益合計	183,586	293,581
営業外費用		
支払利息	27,381	72,406
為替差損	288,478	86,534
雑損失	18,601	14,069
営業外費用合計	334,461	173,011
経常利益又は経常損失(△)	△732,262	2,332,572
特別利益		
固定資産売却益	297	1,014
特別利益合計	297	1,014
特別損失		
固定資産売却損	1,933	—
固定資産除却損	398	2,489
特別損失合計	2,331	2,489
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△734,296	2,331,097
法人税等	△205,422	673,580
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△528,874	1,657,516
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△528,874	1,657,516

(四半期連結包括利益計算書)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△528,874	1,657,516
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	495,884	3,940,453
為替換算調整勘定	394,326	824,282
退職給付に係る調整額	△9,721	△9,499
その他の包括利益合計	880,490	4,755,236
四半期包括利益	351,615	6,412,753
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	351,615	6,412,753

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
減価償却費	689,605千円	854,131千円
のれんの償却額	35,650千円	38,202千円

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間（自2025年4月1日 至2025年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	半導体製造装置事業	メディカルデバイス事業	レーザ加工装置事業	計
売上高				
(1)外部顧客への売上高	7,202,441	594,088	283,692	8,080,222
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—
計	7,202,441	594,088	283,692	8,080,222
セグメント利益又は損失（△）	△607,908	102,507	△75,985	△581,386

(注) セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

各セグメントにおいて、重要な固定資産の減損損失及びのれんの金額の変動はありません。

II 当第1四半期連結累計期間（自2026年4月1日 至2026年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	半導体製造装置事業	メディカルデバイス事業	レーザ加工装置事業	計
売上高				
(1)外部顧客への売上高	15,133,365	680,396	369,726	16,183,487
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—
計	15,133,365	680,396	369,726	16,183,487
セグメント利益又は損失（△）	2,126,326	132,498	△46,823	2,212,002

(注) セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

各セグメントにおいて、重要な固定資産の減損損失及びのれんの金額の変動はありません。